



2021年9月6日

各 位

上場会社名 昭和電工株式会社  
 コード番号 4004 東証第1部  
 代表者 代表取締役社長 森川 宏平  
 問合せ先 CSR・コミュニケーション室長 香川 ユニア  
 TEL (03) 5470 - 3235

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2021年8月23日付の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新株式発行

(1) 募集株式の種類及び数	下記①乃至③の合計による当社普通株式	32,665,500株
	①国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式	15,070,500株
	②海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式	15,529,500株
	③海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式	2,065,500株
(2) 発行価格（募集価格）（注）1.	1株につき	2,465円
(3) 発行価格の総額（注）2.		80,520,457,500円
(4) 払込金額（注）1.	1株につき	2,363.32円
(5) 払込金額の総額（注）2.		77,199,029,460円
(6) 増加する資本金及び（注）2. 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	38,599,514,730円 38,599,514,730円
(7) 申込期間（国内）		2021年9月7日（火）～2021年9月8日（水）
(8) 払込期日		2021年9月13日（月）
(注) 1.	引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。	
2.	海外引受会社が上記(1)③に記載の権利全部を行使した場合の数字です。	

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は、1933年米国証券法（以下、「米国証券法」）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録を行うか又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券に係る売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式	2,524,500株
(2) 売 出 価 格	1株につき	2,465円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		6,222,892,500円
(4) 申 込 期 間	2021年9月7日(火)～2021年9月8日(水)	
(5) 受 渡 期 日	2021年9月14日(火)	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1株につき	2,363.32円
(2) 払 込 金 額 の 総 額		(上限) 5,966,201,340円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	(上限) 2,983,100,670円
	増加する資本準備金の額	(上限) 2,983,100,670円
(4) 申込期間（申込期日）	2021年10月12日(火)	
(5) 払 込 期 日	2021年10月13日(水)	

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年9月6日(月)	2,542円
(2) ディスカウント率		3.03%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年9月9日(木)から2021年10月8日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 82,383,230,800円については、2023年12月末までに、59億円を化学品セグメントにおける電子材料用高純度ガス製造設備等への投資資金に、58億円をエレクトロニクスセグメントにおけるSiCパワー半導体材料及びリチウムイオン電池関連素材の各製造設備等への投資資金に、2024年3月末までに残額である約706億円を昭和電工マテリアルズセグメントにおけるCMPスラリー、銅張積層板、感光性フィルム及び樹脂バックドアモジュールの各製造設備等への投資資金並びにパッケージングソリューションセンタの機能強化及び再生医療製造拠点の能力増強等のための投資資金にそれぞれ充当する予定であります。

詳細につきましては、2021年8月23日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は、1933年米国証券法（以下、「米国証券法」）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録を行うか又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券に係る売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。